



意法半導體公布 2024 年第三季財報

- 第三季淨營收 32.5 億美元；毛利率 37.8%；營業利潤率 11.7%，淨利 3.51 億美元
- 前九個月淨營收 99.5 億美元；毛利率 39.9 %；營業利潤率 13.1%，淨利 12.2 億美元
- 業務展望（中位數）：第四季淨營收 33.2 億美元；毛利率 38%
- 啟動一項全新的公司計畫以重塑製造布局，加速對 12 吋矽和 8 吋碳化矽晶圓廠產能升級，並調整公司全球製造成本結構

【臺北訊，2024年11月8日】— 服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱 ST；紐約證券交易所代碼：STM）公布依照美國通用會計準則（U.S. GAAP）編制之截至2024年9月28日的第三季財報。

意法半導體第三季淨營收達32.5億美元，毛利率37.8%，營業利潤率11.7%，淨利潤為3.51億美元，稀釋每股盈餘37美分。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery，「第三季的淨營收符合業務展望的中位數。個人電子產品營收優於預期，工業領域則略為下滑，車用產品營收則較低。第三季毛利率為37.8%，與業務展望的中位數基本持平。前九個月的淨營收較上年萎縮23.5%，所有產品部門均衰退，特別是微控制器產品，這是因為受到工業市場持續疲軟影響所致。營業利潤率為13.1%，淨利則為12.2億美元。第四季業務展望（中位數）的淨營收預計為33.2億美元，較上年減少22.4%，但較上季成長2.2%；毛利率預計約38%，這是因為受到約400個基點的閒置產能支出影響。依照業務展望的中位數計算，2024年全年營收約132.7億美元，較去衰退23.2%，處於上季指示範圍的低端，毛利率亦略低於預期。根據目前積壓訂單和需求能見度，預計2024年第四季和2025年第一季的營收降幅將遠超正常季節性的波動。我們正在啟動一項全新的公司計畫，以重塑製造佈局，加速晶圓廠對於12吋矽（Agrate和Crolles）和8吋碳化矽（Catania）產能的升級，並調整全球製造成本結構。這項計畫將透過提升營運效率來增加獲利，預計到2027年可節省每年數億美元的成本開支。」

2024年第三季財報重點

美國通用會計準則 (單位：百萬美元，每股收益指標除外)	2024年 第三季	2024年 第二季	2023年 第三季	Q/Q	Y/Y
淨營收	\$3,251	\$3,232	\$4,431	0.6%	-26.6%
毛利潤	\$1,228	\$1,296	\$2,109	-5.2%	-41.8%
毛利率	37.8%	40.1%	47.6%	-230 bps	-980 bps
營業利潤	\$381	\$375	\$1,241	1.8%	-69.3%
營業利潤率	11.7%	11.6%	28.0%	10 bps	-1,630 bps
淨利潤	\$351	\$353	\$1,090	-0.6%	-67.8%
稀釋每股盈餘	\$0.37	\$0.38	\$1.16	-2.6%	-68.1%

2024年第三季回顧

註：意法半導體於2024年1月10日公布新的組織架構，意味著自2024年第一季開始的部門財務報告將有所變更。上一年的

比較資料已完成對應調整。詳見附錄。

各產品部門淨營收 (單位：百萬美元)	2024年 第三季	2024年 第二季	2023年 第三季	Q/Q	Y/Y
類比、MEMS與感測器子產品部 (AM&S)	1,185	1,165	1,367	1.7%	-13.3%
功率與離散元件子產品部 (P&D)	807	747	989	7.9%	-18.4%
類比、功率與離散元件、MEMS與感測器產品部 (APMS) 營收小計	1,992	1,912	2,356	4.2%	-15.5%
微控制器子產品部 (MCU)	829	800	1,466	3.6%	-43.4%
數位IC與射頻子產品部 (D&RF)	426	516	605	-17.4%	-29.7%
微控制器、數位IC與射頻產品部 (MDRF) 營收小計	1,255	1,316	2,071	-4.6%	-39.4%
其它	4	4	4	-	-
淨營收總計	3,251	3,232	4,431	0.6%	-26.6%

2024年第三季淨營收總計32.5億美元，較去年同期減少26.6%。OEM和代理的淨銷售營收則分別較去年衰退17.5%和45.4%。相較上季，微幅增加0.6%，與中位數持平。

第三季毛利潤總計12.3億美元，較去年同期減少41.8%。毛利率為37.8%，與公司業績指引的中位數相比低20個基點，若較去年同期下滑980個基點，係因產品結構有待優化，其次是閒置產能支出增加和產品售價所致。

第三季營業利潤為3.81億美元，去年同期則為12.4億美元，相較去年，下滑幅度69.3%。營業利潤率為11.7%，比2023年第三季的28.0%下降1,630個基點。

相較去年同期各產品部門之表現：

類比、功率與離散元件、MEMS與感測器產品部 (APMS)：

類比產品、MEMS與感測器(AM&S)子產品部 –

- 營收衰退 13.3%，主要受影像和類比產品業務下跌而影響。
- 營業利潤 1.75 億美元，降幅 41.2%。營業利潤率則為 14.8%，對比去年同期為 21.8%。

功率與離散 (P&D) 子產品部 –

- 營收減少 18.4%。
- 營業利潤 1.21 億美元，降幅 54.0%。營業利潤率為 15.0%，對比去年同期則為 26.5%。

微控制器、數位IC與射頻產品部 (MDRF)：

微控制器(MCU)子產品部 –

- 營收萎縮 43.4%，主要受通用微控制器業務下滑影響。
- 營業利潤為 1.16 億美元，降幅 78.2%。營業利潤率為 14.0%，去年同期則為 36.4%。

數位IC和射頻子產品部 (D&RF) –

- 營收下降 29.7%，主要受 ADAS (汽車 ADAS 和資訊娛樂) 產品銷售減少所致。
- 營業利潤為 1.14 億美元，萎縮 49.5%。營業利潤率為 26.8%，去年同期則為 37.3%。

淨利潤和稀釋每股盈餘分別從去年同期的10.9億美元和1.16美元，降至3.51億美元和37美分。

現金流量和資產負債表摘要

(單位：百萬美元)	12 個月					
	2024 年 第三季	2024 年 第二季	2023 年 第三季	2024 年 第三季	2023 年 第三季	過去 12 個月數據 變化
營業活動產生的現金淨額	723	702	1,881	3,764	6,062	-37.9%
自由現金流 (非美國通用會計準則) ¹	136	159	707	813	1,725	-52.9%

2024 年第三季營運產生之淨現金為 7.23 億美元，而去年同期則為 18.8 億美元。

第三季淨資本支出 (非美國通用會計準則) 為5.65億美元，而去年同期則為11.5億美元。

第三季自由現金流 (非美國通用會計準則) 為1.36億美元，去年同期則為7.07億美元。

第三季末庫存為 28.8 億美元，上季為 28.1 億美元，去年同期則為 28.7 億美元。季末庫存周轉天數為 130 天，與上季持平，去年同期為 114 天。

第三季支付現金股息 8,000 萬美元，按照當前股票回購計畫，回購 9,200 萬美元公司股票。

意法半導體的淨財務狀況 (非美國通用會計原則)，截至2024年9月28日，為31.8億美元；截止2024年6月29日，為32.0億美元。流動資產總計63.0億美元，負債總計31.2億美元。截至2024年9月28日，考量到未發生支出的專案撥款預付對流動資產總額的影響，調整後的淨財務表現為28.2億美元。

業務展望

意法半導體2024年第四季營收指引中位數：

- 淨營收預計 33.2 億美元，較上季提升約 2.2%，上下浮動 350 個基點。
- 毛利率約 38%，上下浮動 200 個基點。
- 本業務展望假設 2024 年第四季美元兌歐元匯率約 1.11 美元 = 1.00 歐元，包括當前套期保值合約之影響。
- 第四季關帳日為 2024 年 12 月 31 日。

¹ 關於非美國通用會計準則如何轉換成美國 GAAP 資訊，以及 ST 認為該評核指標之重要理由，請參考附件。

非美國通用會計原則的財務補充資訊使用須知

本新聞稿包含非美國通用會計準則的財務補充資訊。

請注意，這些財務指標未經審核，亦未根據美國通用會計原則編制，因此，不可取代美國通用會計原則財務指標。此外，不得使用這些非美國通用會計準則財務指標與其他公司類似的資訊進行比較。為了彌補這些限制的影響，不應孤立地閱讀非美國通用會計原則的財務補充資訊，而應結合意法半導體根據美國通用會計原則編制的合併財務報表。

欲瞭解意法半導體之非美國通用會計準則財務指標與其對應的美國通用會計準則財務指標調節表，請參閱本新聞稿附錄。

前瞻聲明

本新聞稿中包含一些非歷史事實之敘述是以管理階層當前的觀點和假設，以已知和未知風險和不確定性為前提，對未來做出涉及已知和未知的風險、不確定趨勢的預測陳述，以及其他前瞻性陳述（依照1933年證券法最新版第27A條或1934年證券交易法最新版第21E條之規定），這些風險和不確定趨勢可能由於以下因素而導致實際結果、業績或事件與本聲明所預期的結果、業績或事件存在重大差異：

- 全球貿易政策的變化，包括關稅和貿易壁壘的採用和擴大，可能會影響宏觀經濟環境並對本公司產品需求產生不利影響；
- 不確定的宏觀經濟和產業趨勢（例如，通貨膨脹和供應鏈波動），可能會影響本公司產能和終端市場對產品的需求；
- 客戶需求與預測不同；
- 在瞬息萬變的技術環境中設計、製造和銷售創新產品的能力；
- 本公司、客戶或供應商經營所在地區之經濟、社會、公共衛生、勞工、政治或基礎建設條件的變化，包括由於宏觀經濟或地區事件、地緣政治和軍事衝突、社會動盪、勞工行動或恐怖活動；
- 本公司任何主要代理商出現財務困難或主要客戶大幅減少訂單；
- 本公司產能利用率、產品組合和製造效率和／或滿足供應商或協力廠商製造供應商預留之產能所需的產量；
- 本公司運營所需設備、原物料、公用事業服務、協力廠商製造服務和技術或其他物資供應狀況和成本（包括通貨膨脹導致成本增加）；
- 本公司系統的功能和性能：這些系統面臨網路安全威脅，並支援本公司之製造、財務、銷售等重要營運活動；入侵本公司或客戶、供應商、合作夥伴、協力廠商授權技術提供商的 IT 系統；
- 本公司之員工、客戶或其他協力廠商的個人資料被竊取、丟失或非法使用，以及違反隱私法規；
- 本公司競爭對手或其他協力廠商智慧財產權（IP）主張的影響，以及本公司能否以合理的條款和條件獲得所需技術許可；
- 稅收規則的變化、新的或修訂的立法、稅務審核的結果或國際稅務條約的變化可能影響本公司業績以及準確預估稅收抵免、退稅、減稅和準備金，以及實現遞延所得稅資產的能力，致本公司整體稅務狀況發生變化；
- 外匯市場的變化，尤其是與歐元和本公司營運所用之其他主要貨幣對美元的匯率變化；
- 正在進行之訴訟的結果以及本公司可能成為被告的任何新訴訟的影響；
- 產品責任或保修索賠，因疫情或無法交貨的索賠，或與本公司產品相關的其他索賠，或客戶召回產品包含本公司的晶片
- 本公司、客戶或供應商營運所在地區的自然事件，如惡劣天氣、地震、海嘯、火山爆發或其他自然行為、氣候變化的影響、健康風險和傳染病或全球流行傳染病；
- 半導體產業監管和相關法規加緊，包括與氣候變化和永續發展相關的監管和倡議，以及本公司到 2027 年範圍一和範圍二排放和範圍三部分排放達成碳中和的目標；
- 傳染病或全球傳染病疫情可能會在長時間內繼續對全球經濟產生重大負面影響，也可能對本公司之業務和營運產生重大不利影響；
- 本公司之供應商、競爭對手和客戶之間的橫向和垂直整合導致的產業變化；

- 逐步推動新計畫的能力，能否成功可能受本公司無法控制的因素影響，包括協力廠商提供之重要元件的供貨能力和外包商的表現是否符合預期。

上述前瞻性陳述受各種風險和不確定性之影響，可能導致本公司業務的實際結果和業績與前瞻性陳述產生重大不利差異。某些前瞻性陳述可以透過使用前瞻性術語來辨識，例如「相信」、「預期」、「可能」、「應該」、「將」、「尋求」或類似表達或其否定形式或其他變體或類似術語，或透過對策略、計畫或意圖的討論。

其中一些風險已在「第 3 項」中定義並進行更詳細的論述。重要資訊——風險因素已列入本公司於2024年2月22日提交SEC證券會之截至2023年12月31日的年度Form 20-F年度報告中。如果其中一種或多種風險因素已成為既定事實或基本假設被證明是錯誤的，則實際結果可能會與本新聞稿中預期、相信或預期的結果大不相同。本公司不準備亦無義務更新本新聞稿中的任何產業資訊或前瞻性陳述，反映後續事件或情況。

本公司在不定期報備證券交易委員會之「Item 3.重要資訊——風險因素」檔中列出上述不利變化或其他因素，這些因素可能對本公司之業務和／或財務狀況產生重大不利影響。

關於意法半導體

意法半導體匯聚超過 5 萬名半導體技術的創造者和製造者，掌握半導體供應鏈和先進的製造設備。做為一家整合元件製造商（IDM），意法半導體與逾 20 萬家客戶與數千個合作夥伴一起研發產品和解決方案，攜手建立生態系統，協助客戶因應挑戰和新機會，滿足世界對於永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧，電源和能源管理更高效，物聯網和連接技術的使用更廣泛。意法半導體致力於 2027 年達成碳中和（適用於範圍 1 和範圍 2，以及部分範圍 3）之目標。更多資訊，請瀏覽意法半導體官方網站：www.st.com。